
未來計劃及[編纂]用途

未來計劃

有關我們未來計劃的詳細描述，請參閱「業務－我們的戰略」。

[編纂]用途

假設[編纂]未獲行使，經扣除我們就[編纂]應付的[編纂]佣金及其他預計[編纂]費用，及假設[編纂]為每股股份[編纂]港元（即[編纂]港元至[編纂]港元的中位數），我們預計將收取[編纂]約[編纂]百萬港元。我們擬將[編纂]按下述金額用於以下用途：

- [編纂]的約[編纂]%（或[編纂]百萬港元）將用作資金來源之一，以在未來四年內擴大我們晶圓及模塊的生產能力以及購買及升級生產設備及機器。於往績記錄期間，我們的碳化硅功率模塊及功率半導體柵極驅動的銷量及收入均大幅增長。請參閱「業務－主要經營數據」及「財務資料－經營業績主要組成部分說明－收入」。我們預計，隨著我們實現規模經濟並展示我們的技術能力，這種趨勢將持續下去。同時，得益於碳化硅功率半導體滲透率的不斷提高，碳化硅功率器件市場預計將呈指數級增長，由2025年的人民幣283億元增至2029年的人民幣1,106億元，年複合增長率為40.5%。為應對採用我們產品的終端市場不斷增長的需求，我們計劃審慎且高效地進一步擴大生產能力。具體而言：
 - i. [編纂]的約[編纂]%（或[編纂]百萬港元）將用於購買及升級設備及機器，以擴充我們生產基地的生產線。我們擬於晶圓製造和模塊封裝過程中採用一套精密的先進設備和機器，例如用於在高溫下摻雜半導體材料的高溫離子注入機、用於對碳化硅晶圓進行高溫氧化以形成柵極氧化層的高溫氧化爐、用於對注入碳化硅晶圓的離子進行高溫激活的高溫活化爐、用於通過光刻技術將電路圖案投射到晶圓表面光刻膠上的步進式光刻機以及用於光刻膠塗覆和顯影的相關設備，以確保我們生產運營中的優質產出、高生產效率及製造安全標準；

未來計劃及[編纂]用途

下表載列我們建議分配的[編纂]的詳情，以購買及升級設備及機器，擴充生產基地的生產線：

	<u>[編纂]的擬議分配</u>	<u>[編纂]的具體計劃</u>
	(百萬港元)	
光明生產基地...	[編纂]	擴建光明生產基地的晶圓生產線
其他生產基地...	[編纂]	擴建無錫生產基地、中山生產基地及坪山生產基地的模組生產線
合計	[編纂]	

- ii. [編纂]的約[編纂]% (或約[編纂]百萬港元) 將用於建設光明、中山及坪山生產基地的樓宇及安裝配套設施。這主要包括在相關樓宇的設計、建設及／或室內外裝修以及安裝通風及電力系統等配套設施期間產生的材料成本以及公用事業費用。我們計劃從新銀行及其他借款中籌集建設該等生產基地所需的餘下資金。

下表載列我們建議分配的[編纂]的詳情，以於各生產基地建設樓宇及安裝配套設施：

	<u>[編纂]的擬議分配</u>	<u>[編纂]的具體計劃</u>
	(百萬港元)	
光明生產基地...	[編纂]	安裝配套設施
中山生產基地...	[編纂]	建設樓宇
坪山生產基地...	[編纂]	建設樓宇
合計	[編纂]	

未來計劃及[編纂]用途

下表載列本公司現有及新建生產基地於所示年度的產能與利用率：

	現有產能與利用率		預期產能與利用率											
	2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年	
	產能 ⁽¹⁾	利用率 ⁽²⁾ (%)	產能 ⁽¹⁾	利用率 ⁽²⁾ (%)	產能 ⁽¹⁾	利用率 ⁽²⁾ (%)	產能 ⁽¹⁾	利用率 ⁽²⁾ (%)	產能 ⁽¹⁾	利用率 ⁽²⁾ (%)	產能 ⁽¹⁾	利用率 ⁽²⁾ (%)	產能 ⁽¹⁾	利用率 ⁽²⁾ (%)
光明生產基地(片)....	6,750	45.2	9,000	55.6	12,000	70.0	16,000	85.0	18,000	85.0	18,000	85.0	18,000	85.0
無錫生產基地(件)....	120,000	52.6	120,000	75.0	200,000	80.0	200,000	85.0	200,000	85.0	200,000	85.0	200,000	85.0
坪山測試/生產 基地(件).....	550,000	79.5	-	-	-	-	-	-	300,000	50.0	300,000	80.0	300,000	80.0
中山生產基地(件)....	-	-	-	-	-	-	200,000	50.0	200,000	80.0	200,000	85.0	200,000	85.0

附註：

- (1) 各期產能乃根據各生產基地的每小時產能及工作時數計算得出。
- (2) 年內或期內利用率乃按產量除以同期產能計算得出。

未來計劃及[編纂]用途

我們致力於在適當時限內盡力完成必要的備案程序及取得必要的批准（其中包括建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、投資項目備案、環境影響評估批文及安全生產驗收報告）。據我們的中國法律顧問告知，只要我們的生產及營運不出現重大不利變動，我們完成該等備案程序及取得必要批文並不存在重大法律障礙。

- [編纂]的約[編纂]%（或約[編纂]百萬港元）將用於我們在未來五年內對新碳化硅產品的研發工作以及技術創新。具體而言：
 - i. [編纂]的約[編纂]%（或約[編纂]百萬港元）將用於吸引並招聘更多合資格研發及技術人員，以服務國內及戰略性選定的海外市場（包括德國及日本）。德國的電氣化政策推動了碳化硅功率半導體的需求，並為本土項目提供補貼；而頂尖機構如弗勞恩霍夫協會及領先的汽車原始設備製造商為產業注入人才，並提供尖端研發機會。日本政府持續通過政策支持低功耗半導體研發，擁有具備強大垂直整合能力的IDM企業培育人才，並通過領先的汽車原始設備製造商以及穩健的工業自動化及消費電子行業，提供豐富的應用場景。截至2025年6月30日，我們的研發團隊有142名員工，約佔我們員工總數的28.6%。我們計劃招聘36名中高級研發人員，所有研發人員均擁有豐富的碳化硅功率元件市場研發經驗，以提升我們的技術與創新能力。所有中層研發人員將持有碩士學位，而高級研發人員將持有博士學位。具體而言，我們計劃在中國招聘23名研發人員並在海外市場招聘13名研發人員；
 - ii. [編纂]的約[編纂]%（或約[編纂]百萬港元）將用於加強我們的研發基礎設施、採購相關設備，以及用於其他研發費用，以滿足我們不斷增長的業務需求。例如，我們計劃購買靜態和動態測試設備、絕緣及耐壓測試設備以及功率循環測試設備、環境試驗箱、激光焊接設備和燒結設備，主要用於我們的碳化硅分立器件及碳化硅功率模塊的設計、原型製作及測試。

未來計劃及[編纂]用途

下表載列我們計劃採購的研發設備數量與單價詳情：

研發設備類別	設備數量	單價
	(台)	(人民幣千元)
靜態和動態測試設備	4	1,200-2,050
絕緣及耐壓測試設備	1	115-500
功率循環測試設備	8	1,670-1,780
環境試驗箱	10	300-500
激光焊接設備	1	340-1,800
燒結設備	3	2,000-5,500
其他	18	800-990 ⁽¹⁾

附註：

(1) 計劃採購的所有其他數十種設備的平均單價區間。

- [編纂]的約[編纂]% (或[編纂]百萬港元) 將用於我們在未來五年內拓展碳化硅產品的全球分銷網絡。具體而言：
 - i. [編纂]的約[編纂]% (或[編纂]百萬港元) 將用於擴大我們於中國以及包括德國、日本及香港等海外市場的銷售及營銷。我們將通過全面的市場調研來確定未來發展的目標區域，聚焦於包括目標區域的市場規模、潛在客戶及研發資源等在內的因素。尤其是，我們將招聘59名銷售及營銷人員，其中43名將在中國，16名將位於海外市場(包括德國7名、日本4名、韓國3名及香港2名)，並支付他們未來五年的僱員薪酬及福利。其亦將用於支付與在日本及香港建立銷售中心相關的其他開支，包括物業租賃開支及其他輔助費用。我們認為，此舉將擴大我們銷售網絡的地理覆蓋範圍，並吸引更多從事碳化硅產品相關下游應用領域的客戶，尤其是在電動汽車、數據中心及可再生能源行業；

未來計劃及[編纂]用途

- ii. [編纂]的約[編纂]% (或[編纂]百萬港元) 將用於營銷活動，如組織及參與行業會議、展會及論壇，以及相關差旅及交通。我們認為參與該等營銷活動將使我們與潛在客戶建立聯繫並展示我們碳化硅產品的技術優勢，從而促進並加速我們產品市場滲透率的提升。
- [編纂]的約[編纂]% (或[編纂]百萬港元) 將用於營運資金及其他一般公司用途。

倘[編纂]設定為[編纂]的最高[編纂]或最低[編纂]，[編纂]將分別增加或減少約[編纂]百萬港元。

倘[編纂]獲悉數行使，我們將收取的額外[編纂]將為：(i)約[編纂]百萬港元(假設[編纂]為每股股份[編纂]港元，即[編纂]的最高[編纂])；(ii)約[編纂]百萬港元(假設[編纂]為每股股份[編纂]港元，即[編纂]的中位數)；或(iii)約[編纂]百萬港元(假設[編纂]為每股股份[編纂]港元，即[編纂]的最低[編纂])。

倘[編纂]高於或低於預期，我們將按比例調整用於上述目的的[編纂]的分配。

倘[編纂]並未立即用於上述用途或倘我們無法按計劃實施我們未來發展計劃的任何部分，我們會將有關資金存入持牌商業銀行及／或其他授權金融機構(定義見《證券及期貨條例》或其他司法管轄區適用法律法規)的短期計息賬戶，只要其被視為符合我們的最佳利益。於該情況下，我們將遵守《上市規則》項下適當披露要求。

倘我們發展計劃的任何部分因為政府政策變動等原因無法按期進行，阻礙我們任何項目發展，或者發生不可抗力事件，則董事將仔細評估情況並可能重新分配[編纂]。